

4



PCT
WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM
Internationales Büro
INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation ⁶ : H01L 21/607, 21/60, 21/61, 21/98		A1	(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 99/23697
			(43) Internationales Veröffentlichungsdatum: 14. Mai 1999 (14.05.99)
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP98/06295		(81) Bestimmungsstaaten: CN, JP, KR, SG, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).	
(22) Internationales Anmeldedatum: 2. Oktober 1998 (02.10.98)			
(30) Prioritätsdaten: 197 47 846.8 30. Oktober 1997 (30.10.97) DE		Veröffentlicht <i>Mit internationalem Recherchenbericht</i>	
(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): DAIMLER-BENZ AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Epplestrasse 225, D-70567 Stuttgart (DE). SHANGHAI INSTITUTE OF METALLURGY [CN/CN]; Chinese Academy of Sciences, Shanghai 200050 (CN).			
(72) Erfinder; und			
(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): XIE, Xiaoming [CN/CN]; Hua Yuan Cun Ding, Xiang Yuan 61-602, Shanghai 200233 (CN). SHEN, Zhongzhe [CN/CN]; Dingxi Road 1267, Shanghai 200050 (CN). FRBYTAG, Jürgen [DE/DE]; Finkenweg 5, D-63329 Egelsbach (DE). STUBHAN, Frank [DE/DE]; Rubensstrasse 9, D-63110 Rodgau (DE).			
(74) Anwalt: MAUTE, Hans-Jürgen; Daimler-Benz Aktiengesellschaft, Intellectual Property Management, Sedanstrasse 10/Geb.17, D-89077 Ulm (DE).			
(54) Title: COMPONENT AND METHOD FOR PRODUCTION THEREOF			
(54) Bezeichnung: BAUELEMENT UND VERFAHREN ZUM HERSTELLEN DES BAUELEMENTS			
(57) Abstract			
The invention relates to a component and to a method for the production thereof. Said component is more particularly an electronic component with a micro electronic chip and a carrier which is produced by means of isothermal coagulation.			
(57) Zusammenfassung			
Die Erfindung betrifft ein Bauelement und ein Verfahren zum Herstellen des Bauelements, insbesondere eines elektronischen Bauelements mit einem mikroelektronischen Chip und einem Träger, welches mit isothermer Erstarrung hergestellt ist.			

1
2
3